

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **VFBGA10H-121**

JEITA Package name; **(P-VFBGA-121-1010-0.80)**

Solder ball Type; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.16 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	10	シリコン	7440-21-3	9.8	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00002	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00005	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0002	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00005	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00002	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0002	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0002	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0003	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00002	2	配線材
PKG	保護膜	0.2	ポリイミド	-	0.20	1000000	保護膜 ※4
	回路基板	42	ガラスクロス	-	2.2	52140	強化材
			無機フィラー	-	1.1	26180	充填剤
			ハロゲン系樹脂添加剤	-	3.5	81400	樹脂難燃剤
			エポキシ樹脂	-	3.7	86280	主剤
			アクリレート系樹脂	-	2.3	54600	主剤
			顔料	-	2.0	46800	添加剤
			有機フィラー	-	0.11	2600	充填剤
			ヒ素	7440-38-2	0.001	26	耐熱性向上
			クロム化合物	-	0.0008	20	耐熱性向上
			銅	7440-50-8	26.7	629154	銅箔(パターン配線)
			ニッケル	7440-02-0	0.72	16900	メッキ
			金	7440-57-5	0.17	3900	メッキ
	ダイアタッチ材	3.0	エポキシ樹脂	-	2.0	670000	接着剤
			アクリル樹脂	-	0.99	330000	接着剤
	半田ボール	25	錫	7440-31-5	23.7	957500	半田成分
			銀	7440-22-4	0.87	35000	半田成分
			銅	7440-50-8	0.19	7500	半田成分
	ボンディングワイヤー モールド樹脂	2.3	金	-	2.3	1000000	導体材
		78	エポキシ樹脂	-	3.9	50000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	67.7	873000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.16	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	3.9	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	0.39	5000	硬化促進剤
			その他	-	1.6	20000	添加剤

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。
従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。